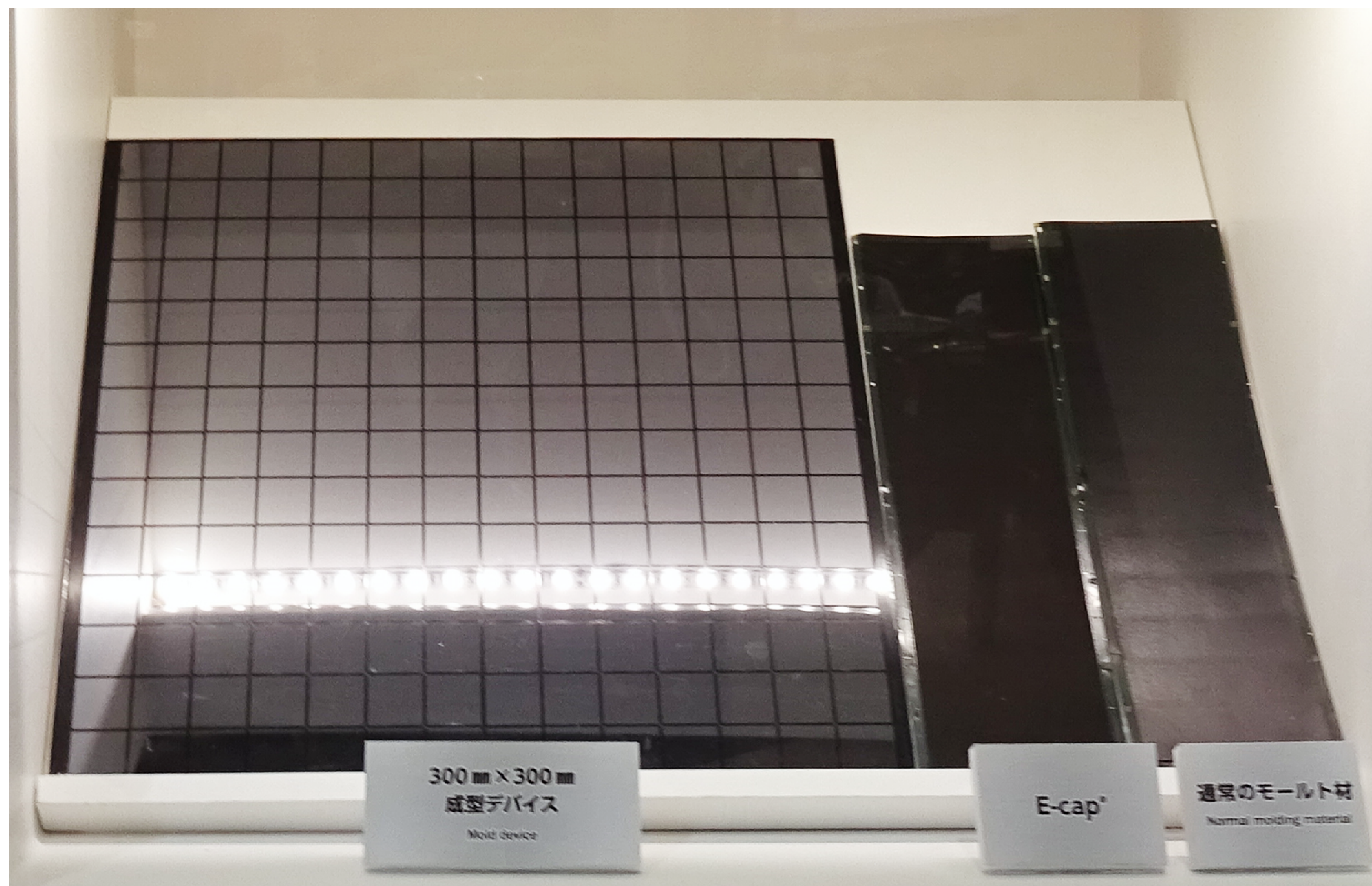


次世代の成型システム 「E-cap®」

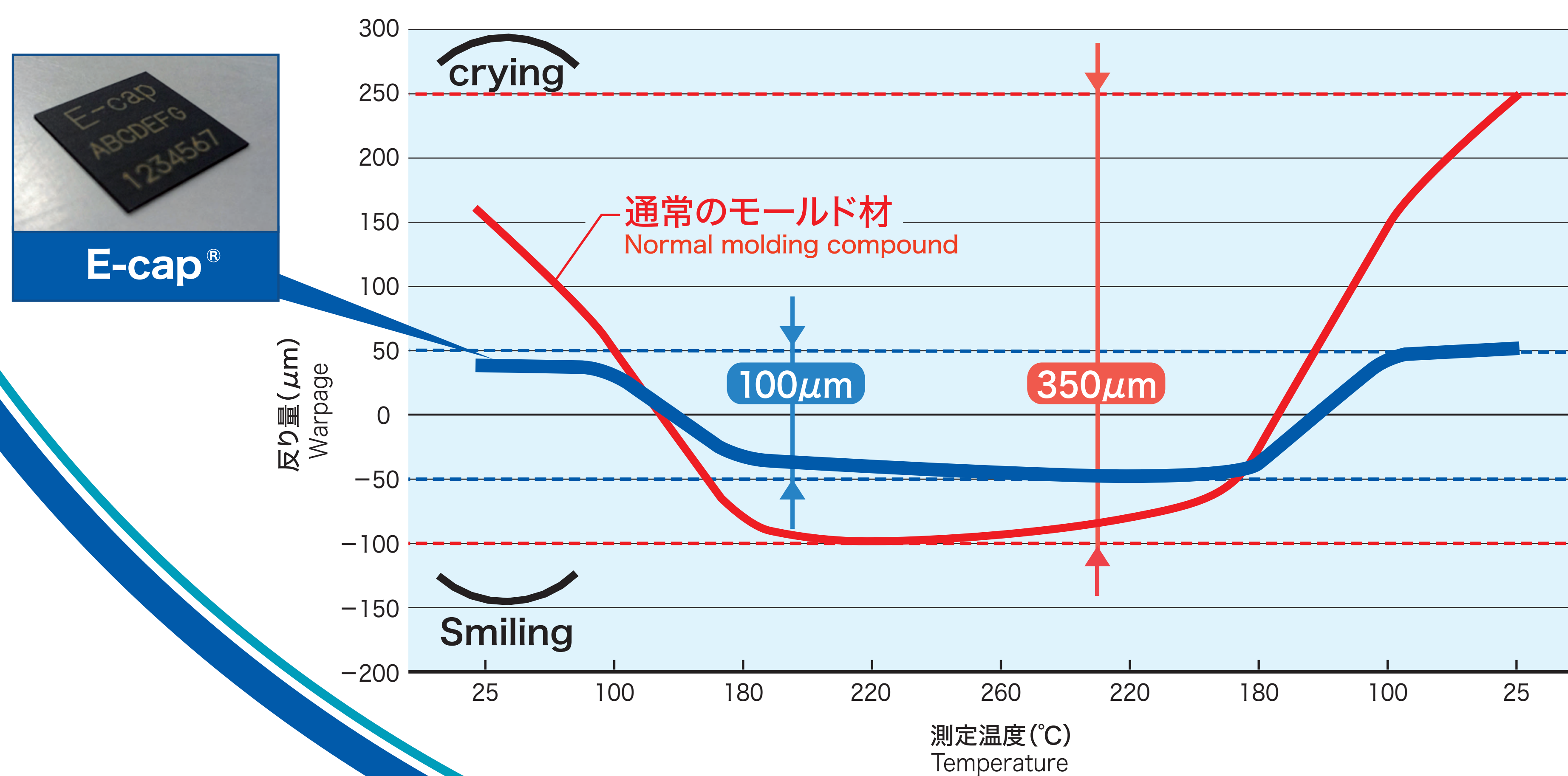
New mold system "E-cap®"

反り問題を**解決!**
No more warpage issue!

大面積 Fan-out 封止 (300mm×300mm)
Large size "Fan-out" device



個片化後の反り量の比較例
Warpage behavior after dicing



信頼性試験 評価例
Reliability test result

MSL1: 85°C/85%RH, 168h + IR260°C×3
MSL2: 85°C/60%RH, 168h + IR260°C×3
HAST: 130°C/85%RH, 500h
TCT: -65 → 150°C/85%RH, 500h

剥離、クラックなし
No delamination,
No crack